

证券代码：688037 证券简称：芯源微 告编号：2024-061

沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于订单和战略 新品进展情况的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）始终致力于半导体专用设备的国产化，产品包括光刻工序涂胶显影设备、单片式湿法设备、临时键合及解键合设备等，广泛应用于国内各大晶圆厂、先进封装厂、化合物半导体等厂商。作为国内涂胶显影细分领域龙头，公司产品已成功实现在前道晶圆加工领域 28nm 及以上成熟制程工艺节点全覆盖，14nm 及以下先进制程工艺技术也在有序验证中。此外，公司在前道物理清洗、后道先进封装、化合物半导体等领域也长期保持行业领先地位。

为了能够让广大投资者更为详细及时地了解公司的经营情况，现将公司订单及战略新品进展情况公告如下：

一、新签订单情况

2024 年上半年，公司新签订单 12.19 亿元，同比增长约 30%。其中，前道涂胶显影新签订单同比保持良好增长，后道先进封装及小尺寸新签订单同比较大幅度增长，应用于 Chiplet 领域的新产品临时键合、解键合等新签订单同比增长超过十倍，公司战略性新产品前道单片式高温硫酸化学清洗设备也获得国内重要客户订单。截至 2024 年 6 月底，公司在手订单超过 26 亿元，创历史新高。

二、战略新品进展情况

2024 年 8 月 30 日上午，公司即将在上海临港新厂区启运首台前道单片式高温硫酸化学清洗机 KS-CM300 到客户端开展工艺验证。该机台是公司上海子公司自主研发的首款高端设备，适用于 Pre-deposition、Post-thinfilim、Post-etch、

Post-imp、Post-CMP、PR-strip、NiPt remove 等多种工艺，机台所用高温 SPM 清洗工艺被业界公认为 28nm/14nm 制程性能要求最高的工艺之一，也是业内最具难度和挑战的湿法工艺。

公司研发的该款设备有望打破国外龙头对高温硫酸清洗技术的绝对垄断，机台性能及工艺技术致力于达到国际先进水平，能够实现 26 纳米以下少于 30 个剩余颗粒的处理，在连续跑片十万片条件下，可满足客户 Up-Time \geq 95%、刻蚀均一性 \leq 2% 等严苛性要求，其研发与验证有望解决国内客户在该领域受制于人的不利局面，对推动国产高端半导体清洗装备自主可控具有重要战略意义，也是公司拓展前道化学清洗领域的里程碑事件。

相关说明及风险提示：

1、以上新签订单及战略新品进展受具体执行、验证进度等因素影响，对公司未来业绩的影响存在不确定性。在履行过程中若遇不可抗力等因素的影响，不排除部分订单存在部分或全部无法履行或终止的风险；

2、以上新签订单数据源自公司内部统计，未经审计，不能以此直接推算公司全年营业收入、净利润等财务数据，仅供投资者及时了解公司日常经营概况。准确的财务数据以公司正式披露的定期报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日